

证券代码：301566

证券简称：达利凯普

大连达利凯普科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-005

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他
参与单位名称	银河证券、招商基金
时间	2026 年 9 月 23 日 14:00-15:00
地点	线上会议交流
上市公司接待人员姓名	董事会秘书才纯库
投资者关系活动主要内容介绍	介绍公司基本情况 交流的主要内容 问题一：请介绍一下公司业务和客户情况？ 答：公司主营业务为射频微波瓷介电容器的研发、制造及销售，致力于向客户提供高性能、高可靠性的电子元器件产品。公司目前主要产品包含射频微波 MLCC 及射频微波 SLCC 等，具有高 Q 值、低 ESR、高自谐振频率、高耐压、高可靠性等特点，广泛应用于工业类产品射频微波电路之中。公司凭借优异的产品性能和服务能力，与多家知名移动通讯基站设备、医疗影像设备、轨道交通信号设备、半导体射频电源及激光设备和仪器仪表生产商建立了合作关系。在移动通讯基站设备领域，公司已成为移动通讯基站主设备商等企业的供应商；在医疗影像设备领域，公司与通用医疗（GE Healthcare）、西门子医疗

	(Siemens Healthineers)、联影医疗等大型医疗影像设备制造商保持长期合作关系；轨道交通信号设备领域，公司是中国通号的射频微波 MLCC 供应商；半导体射频电源及激光设备领域，公司已进入 Advanced Energy Industries、MKS Instruments, Inc. 等知名半导体、电源技术公司的供应体系。 问题二：公司具体经营模式是怎样的？ 答：公司掌握生产射频微波瓷介电容器相关生产工艺流程及技术，自主生产公司产品。在生产计划制定和实施方面，公司主要采用以销定产和备货式生产相结合的生产模式。公司在获取客户产品采购订单后，生产部门从客户订单出发，在满足客户产品需求的基础上，综合考虑生产进度和材料利用率等情况进行排产，并将生产任务进一步分配落实，从而提高产能利用效率和供货及时性。与此同时，因公司从采购到生产、供货需要一定周期，故公司会根据客户预计的订单需求量提前进行生产，客户实际订单下达后进行交付，以便于应对较大批量的产品交付或交货期要求较高的产品订单。 问题三：公司的研发投入情况方便展开介绍一下吗？ 答：公司研发工作由总工程师统筹开展，公司设立技术部，负责各个研究开发项目实施，组织与监督项目开发各个阶段的工作。公司研发部门主要分为四个条线，包含新产品研发、材料研发、分析中心和射频应用中心。新产品研发条线主要承担公司新产品研发项目；材料研发条线主要承担陶瓷材料、金属电极材料的研发项目；分析中心主要对其他条线的研发活动进行分析支持；射频应用中心主要针对公司射频微波产品的性能指标提供检测、仿真测试与相应研发支持。公司研发项目主要分为外部研发和内部研发两类。外部研发主要为承接外部研发项目，公司主要通过招投标方式竞标取得相应项目的研发资格后展开研发；内部研发主要为公司根据市场、客户需求及自身发展规划产生研发需求，进而通过可行性分析、内部立项评审
--	---

	等程序后展开研发。公司研发项目执行过程中，项目负责人编制项目《设计和开发计划书》，明确设计和开发各阶段工作内容、完成时间，项目负责人严格按照计划开展设计和开发；技术部根据《设计和开发计划书》的进度安排，在转阶段时间节点，对项目进行监督检查，检查是否按计划完成开发任务；研发项目结题时，公司将按照相应标准或要求进行验收，并进行产品鉴定检验，技术部根据鉴定检验结果及用户使用报告进行验收，组织定型评审，定型评审合格，则科研项目完成。 问题四：公司董事、高管减持股份预计何时结束？是出于什么原因减持？ 答：公司董事、高级管理人员吴继伟先生减持区间为 2026 年 6 月 26 日至 2026 年 9 月 25 日。股东的资金规划与决策，系基于其自身财务安排需要，并不代表对公司未来发展的判断。公司将继续加强信息披露透明度，积极与投资者沟通，努力以稳健的业绩和成长性回报广大投资者的信任与支持。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 9 月 23 日